

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 3 部門第 3 区分

【発行日】平成24年1月12日 (2012.1.12)

【公表番号】特表2011-506715(P2011-506715A)

【公表日】平成23年3月3日 (2011.3.3)

【年通号数】公開・登録公報2011-009

【出願番号】特願2010-538529(P2010-538529)

【国際特許分類】

C 0 8 F 210/14 (2006.01)

B 2 9 C 55/28 (2006.01)

C 0 8 J 5/18 (2006.01)

B 2 9 K 23/00 (2006.01)

B 2 9 L 7/00 (2006.01)

【F I】

C 0 8 F 210/14

B 2 9 C 55/28

C 0 8 J 5/18 C E S

B 2 9 K 23:00

B 2 9 L 7:00

【手続補正書】

【提出日】平成23年11月18日 (2011.11.18)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

5 ~ 9 重量 % のヘキセン - 1 から誘導される繰り返し単位を含み、125 ~ 140 の融点、及び 0.1 ~ 3 g / 10 分のメルトフローレート (ASTM - D 1238、230 / 2.16 kg) を有する、プロピレンとヘキセン - 1 とのコポリマー。

【請求項 2】

25 重量 % 以下の室温におけるキシレン中の溶解度を有する、請求項 1 に記載のコポリマー。

【請求項 3】

透明化剤を含む、請求項 1 又は 2 に記載のコポリマー。

【請求項 4】

塩化マグネシウム上に担持されているチタン化合物及び電子ドナー化合物を含む固体成分、アルミニウムアルキル化合物、及び外部電子ドナー化合物を含む立体特異性チーグラ- ナッタ触媒の存在下で行う、請求項 1 ~ 3 のいずれか 1 項に記載のポリマーを製造するための重合方法。

【請求項 5】

外部電子ドナー化合物が、少なくとも 1 つの Si - OR 結合 (ここで R は炭化水素基である) を含むケイ素化合物から選択される、請求項 4 に記載の重合方法。

【請求項 6】

外部電子ドナー化合物がテキシルトリメトキシシランである、請求項 4 又は 5 に記載の重合方法。

【請求項 7】

請求項 1 に記載のプロピレンとヘキセン - 1 とのコポリマーを含むブローンフィルム。

【請求項 8】

250  $\mu$ m より小さい厚さを有する、請求項 7 に記載のブローンフィルム。

【請求項 9】

請求項 7 又は 8 に記載のブローンフィルムを含む商品及び食品の包装材。

【請求項 10】

請求項 1 に記載のプロピレンとヘキセン - 1 とのコポリマーを用いて少なくとも 1 つのフィルム層を形成する、ブローンフィルムの製造方法。

【請求項 11】

- ・スクリュウ直径の 20 ~ 40 倍のスクリュウ長さ；
- ・160 ~ 270 のパレル及びダイ温度；
- ・3 mm 以下の環状ダイギャップ；
- ・2 . 2 ~ 4 のブローアップ比；
- ・5 ~ 20 の冷却媒体温度；

の条件下で行う、請求項 10 に記載の方法。